

第十五届计算机建模与仿真国际会议

2023年6月16-18日 | 中国大连 | <http://www.iccms.org/>

第十五届计算机建模与仿真国际会议(ICCMS 2023)将于2023年6月16-18日在中国大连召开。本次会议由大连理工大学主办，重庆邮电大学联合主办。

ICCMS自2009年创办以来，已先后在意大利、中国、澳大利亚、荷兰等多个国家与地区成功举办十四届，已累计全球各地近两千名专家学者参会，开设近两百余场学术分会场。会议往届论文集由著名出版社ACM出版，已被Ei核心检索。会议关注计算机建模与仿真领域的新理论及其应用，为相关研究领域的专家、学者交流最新研究成果、探讨学术发展方向提供一个广泛的交流平台。欢迎相关研究领域各校师生、科研院所和企业广大科技人员踊跃投稿！

会议组委会

咨询主席

张霖教授，北京航空航天大学

会议主席

屈洪春教授，重庆邮电大学

Prof. Ghassan Beydoun, 澳大利亚悉尼科技大学

会议联合主席

Prof. Prabhat Kumar Mahanti, 加拿大新不伦瑞克大学

张发教授，北京理工大学珠海学院

张栋副教授，大连理工大学

指导委员会

廉莲副教授，大连理工大学

会议宣传主席

周鹏飞副教授，大连理工大学

孙开琼副教授，武汉轻工大学

会议组织主席

唐国磊副教授，大连理工大学

陈震副教授，大连理工大学

会议区域主席

姚荣涵教授，山东理工大学

朱援教授，内蒙古大学

主题报告嘉宾



张霖教授

SCS Fellow

北京航空航天大学

持续更新中....

特邀报告嘉宾

- 李雄教授，中山大学
- 陈振雷教授，宁波大学
- 李钦策副研究员，哈尔滨工业大学

投稿须知

投稿要求

- 语言: 会议官方语言为英语，只接受英文论文，投稿者请务必用英语撰写论文。

投稿类型

- 摘要: 只做报告不出版
- 全文: 报告&出版，文章不能少于8页，文章超过10页的部分将收取超页费用

投稿方式(两种投稿方式二选一，请勿重复投稿)

- 请点击链接提交您的投稿：<http://confsys.iconf.org/submission/iccms2023>
- 以附件形式发送到邮箱：iccms_contact@163.com

征稿主题

- Agent Based Simulation
- Bond Graph Modeling
- Circuit Simulation & Modeling
- Computational and Systems Biology
- Computer Games and Simulation
- Device Simulation & Modeling
- Discrete and Numerical Simulation
- Emerging Technologies and Applications
- Finite and Boundary Element Techniques
- High Performance Computing & Simulation
- Interaction Paradigms and Human Factors
- Knowledge-based Simulation
- Modeling and Simulation Methodologies
- Object-oriented Simulation
- Process Simulation and Modeling
- Prototyping and Simulation
- Simulation of Complex Systems
- Vision and Visualization
- Knowledge-based Simulation
- Parallel and Distributed Computing Simulation
- Perceptual Issues in Visualization and Modeling
- Prototyping and Simulation
- Real-time Modeling and Simulation
- Simulation and Modeling in Molecular Biology
- Production, Logistics and Transport
- Simulation Application in Industry
- Information and Scientific Visualization
- Internet, Web and Security Visualization

更多主题，欢迎访问：<http://www.iccms.org/cfp.html>

会议论文集

投稿文章将经过严格的审稿过程，最终录用并完成注册和报告的文章将由ACM出版到ICCMS 2023会议论文集（ISBN号：979-8-4007-0791-9），收录在ACM数据库中，并被Ei Compendex和Scopus检索。

ICCMS 2017-2022会议论文集已被Ei Compendex和Scopus检索

重要日期

投稿截止时间: 2023年5月15日

通知截止时间: 2023年5月30日

注册截止时间: 2023年6月6日

联系我们

- 联系人: 刘老师
- 邮箱: iccms_contact@163.com
- 电话: 18302820449
- 微信: csit2009

主办单位



联合主办单位

